

京鼎精密科技股份有限公司

2024第二季法人說明會

2024/9/5

免責聲明



- 本簡報及同時發佈之相關訊息內・含有從公司內部與外部來源所取得的預測 性資訊。
- ■本公司未來實際所發生的營運結果、財務狀況以及業務展望,可能與這些預測性資訊所明示或暗示的預估有所差異,其原因可能來自於各種本公司所不能掌控的風險。
- ■本簡報中對未來的展望,反應本公司截至目前為止對於未來的看法。對於這些看法,未來若有任何變更或調整時,本公司並不負責隨時提醒或更新。

會議議程



■公司簡介

■財務報告

■營運與展望

■問答交流

李貞誼發言人鄒永芳財務長

鄒永芳財務長李貞誼發言人徐朝煌協理陳鎮福特助

公司簡介



成立時間:2001/4/26

董事長:劉揚偉

總 經 理 :邱耀銓

資 本 額 : 10.38億元

市 值:356.7億元(截至2024/9/2) 員工人數:3,112人(截至2024/8/31)

營業項目:

■ 半導體前段製程設備關鍵模組及零部件製造服務

■ 半導體設備及零部件再生循環

■ 半導體自動化設備之研發、製造及銷售並提供整合性解決方案

2001 公司設立

榮耀與里程碑:

2002 通過世界第一大半導體設備製造商之合格供應商認證,開始量產

2015 TWSE 掛牌上市

2020 京鼎榮獲SGS 2020 CSR Awards - 菁英獎

2022 獲頒的「2022亞洲企業最佳雇主獎」及商周評比「碳競爭力100強」企業

2023 京鼎首本永續報告書榮獲2023 TCSA永續報告書銅獎

2024 榮獲世界第一大半導體設備製造商「2023年度傑出供應商」雙獎項肯定



全球佈局



量產基地 台灣:745人

竹南科中廠(HQ)



竹南科研廠



大陸: 2,292人

上海松江廠



江蘇昆山廠



美國:75人 新產品開發中心





China+1

建置中



春武里廠

泰國春武里廠



林查班國際海港

竹南



機場(2028啟用)



美國加州/德州辦公室



●:營運製造據點-科中廠/科研廠/松江廠/昆山廠

●:營運製造據點(未來)-泰國

●:新產品導入與小量生產據點-矽谷,USA

●:銷售服務據點-台灣/江蘇/加州/德州

市場定位



1.半導體前段製程設備

2.半導體自動化設備



半導體設備生命週期製造服務

Critical Component/ Technology

- Critical Components/Spare **Parts**
- High Purity/Vacuum Components
- Wafer Process Kits
- Process Vacuum Chambers
- Transfer Vacuum Chambers

High Level system vertical Integration

- Thin Film
- ETCH & EPI & RTP
- Power Distribution

System

- Semi/Solar/Medical **System Integration**
 - System Virtual **Integration & Testing**
 - Merge-in-Transit to **Consolidation Hub**

Engineering/ Designing

- R&D Engineering
- Concurrent Design
- ODM/JDM Design **Virtual Factory**
- DFx Collaboration
- EC Control & **Management**
- Equipment Installation

晶圓生產效率改善及良率提升之解決方案



技術藍圖驅動 創新技術研發



自主產品標準 機種研發



產品標準化模 組化搭配客製 化開發

關鍵部件提供者

高階系統整合商

NPI合作夥伴

產業/產品佈局

- 半導體晶圓製程設備製造(蝕 刻、薄膜、化學機械研磨及 檢測設備)
- 能源設備(Solar/LED) 製造
- 關鍵製程備品耗材

半導體製程相關 設備生命週期 製造服務



- 設備開發(非製程類)
 - > 晶圓智動化
 - > 光罩智動化
 - > 晶圓檢測
 - > 微污染防治

- 設備再生循環服務
- 零部件再生循環服務
- 技術衍生應用服務



醫療設備開發及 製造服務

- 醫療影像診斷設備
- 醫療設備關鍵零組件
- 放射治療設備



綜合損益表



Q2三率三升

單位:新台幣百萬元	2024	1Q24	QoQ%	2Q23	YoY%	1H24	1H23	YoY%
營業收入淨額	3,721 100.0%	3,322 100.0%	12.0%	3,292 100.0%	13.0%	7,043 100.0%	6,695 100.0%	5.2%
營業毛利	992 26.7%	835 25.1%	+1.6 ppts	841 25.5%	+1.2 ppts	1,827 25.9%	1,732 25.9%	
營業費用	(386) (10.4%)	(353) (10.6%)		(350) (10.6%)		(739) (10.5%)	(691) (10.4%)	
營業利益	606 16.3%	482 14.5%	+1.8 ppts	491 14.9%	+1.4 ppts	1,088 15.4%	1,041 15.5%	-0.1 ppts
營業外損益	141 3.8%	263 7.9%		228 6.9%		404 5.8%	219 3.3%	
稅前淨利	747 20.1%	745 22.4%	-2.3 ppts	719 21.8%	-1.7 ppts	1,492 21.2%	1,260 18.8%	+2.4 ppts
本期淨利	696 18.7%	545 16.4%	+2.3 ppts	609 18.5%	+0.2 ppts	1,242 17.6%	1,012 15.1%	+2.5 ppts
歸屬予:								
母公司股東	696	545	27.7%	609	14.3%	1,242	1,012	22.7%
基本每股盈餘(元)	6.75	5.52	1.23	6.27	0.48	12.29	10.42	1.87
加權平均流通在外股數(百萬股)	103.09	98.91	98.91 97.16			101.00 97.13		

資產負債表及重要財務指標



單位:新台幣百萬元

現金及流動金融資產

應收帳款

存貨

長期投資

不動產、廠房及設備

資產總計

應付帳款

銀行借款

應付公司債

流動負債

負債總計

股東權益總計

重要財務指標

平均收現天數

平均銷貨天數

平均付現天數

淨營運現金週期天數

流動比率(倍)

2Q24					
11,169	53%				
1,472	7%				
2,984	14%				
396	2%				
4,013	19%				
21,254	100%				
1,272	6%				
1,624	8%				
836	4%				
5,233	25%				
8,314	39%				
12,940	61%				
29					
102					
39					
92					
3.05					
3.0.					

1Q24		2Q23		
10,921	54%	10,408	53%	
1,122	6%	919	5%	
2,587	13%	2,904	15%	
359	2%	569	3%	
3,994	20%	3,723	19%	
20,161	100%	19,514	100%	
1,073	5%	956	5%	
1,679	8%	1,834	9%	
1,028	5%	1,859	10%	
4,798	24%	6,668	34%	
8,194	41%	9,042	46%	
11,967	59%	10,472	54%	

26	26
99	126
37	44
88	108
3.12	2.16

現金流量表



單位:新台幣百萬元	1H24	1H23
期初現金	6,956	8,544
營運活動之現金(流出)流入	691	837
資本支出	(437)	(350)
定期存款	50	(3,382)
銀行借款淨變動	153	73
投資與其他	158	34
期末現金	7,571	5,756
自由現金流量*	254	487

^{*}自由現金流量=營運活動之現金流入-資本支出



營運與展望

營收趨勢



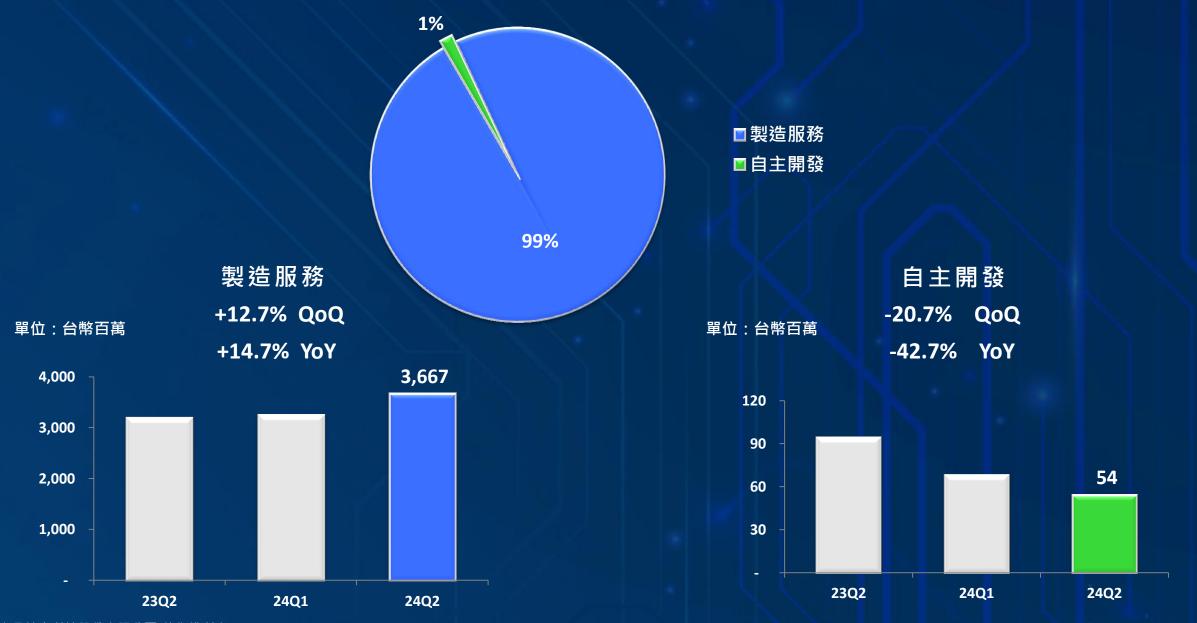
- Q2營收37.21億 QoQ +12% YoY +13%, 創下同期新高
- 2024H1營收70.43億 YoY +5.2%,同創同期新高



註:製造服務=半導體/面板設備關鍵部件製造+能源設備關鍵部件製造;自主開發=自動化設備

2024年第二季銷售分析-業務別

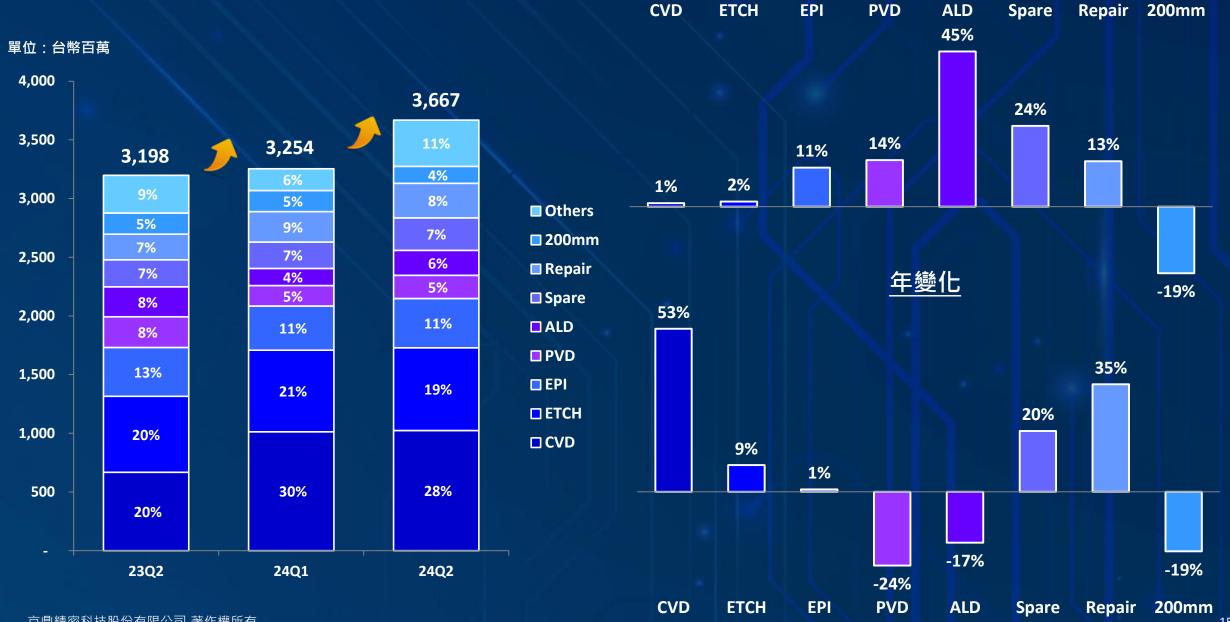












2024年第三季展望





QoQ





製造服務

QoQ



YoY



自主開發

QoQ



YoY



產業趨勢



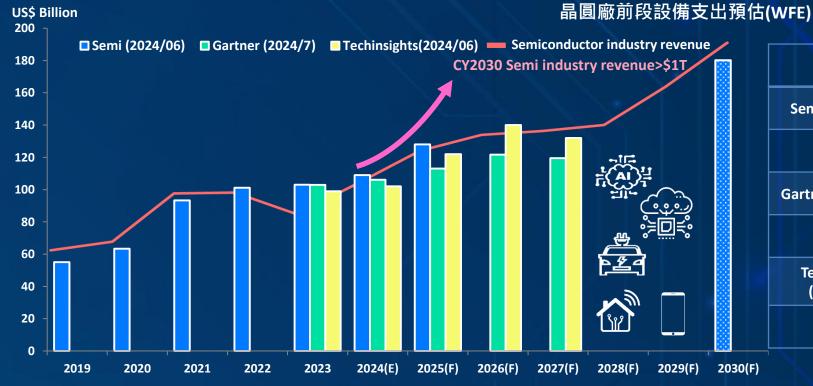
■ AI/HPC等新興科技應用擴增,推升高頻寬記憶體(HBM)、先進邏輯設備成長及產能利用率提升,帶動整體半導體設備和市場持續增 長

■ 三大研調機構預估WFE

▶ 2024年: 小幅增加3%~6%

▶ 2025~2026年: 大幅成長7%-20%

■ 新興科技領域市場內含矽含量不斷提升、半導體製程技術複雜化、各國建立自主半導體供應鏈及晶圓廠產能利用率增加下,推升半導 體設備產業趨勢長期向上



WFE(\$B)	2023	2024(F)	2025(F)	2026(F)	2027(F)
Semi (2024/06)	103	109	128		
YoY		6%	17%		
Gartner (2024/07)	103	106	113	122	119
YoY	2%	3%	7%	8%	-2%
TechInsights (2024/06)	99	102	122	140	132
YoY		3%	20%	15%	-6%

Source:Semi/Gartner/TechInsights

近期重要事件摘要



- 京鼎公司已於7月31日配發2023年盈餘之現金股利,總額為新台幣1,173,260 仟元,每股約新台幣11.29991481元
- 董事會通過追加泰國設廠的資本支出預算案,預算金額由美金1.2億元增加至美金2.92億元
- 京鼎子公司凱諾科技於9月4~6日參加台灣國際半導體展(SEMICON Taiwan 2024)展示最新半導體及EUV光罩自動化設備與技術

總結



- 2024上半年營收、獲利雙成長
 - ▶ 上半年EPS12.29元,賺逾1個股本,寫下歷史新高紀錄
 - ➤ Q2三率三升, EPS 6.75元寫單季次高
- Q3營運力拚高峰,2024營運將超越半導體設備市場表現
- AI應用推動記憶體和先進邏輯製程設備成長及產能利用率提升,助力公司營收表現
- 既有客戶/產品的持續成長,新客戶與新產品的深耕佈局,維持公司營運成長動能
- 加速佈局中國+1產能來因應地緣政治影響並迎接半導體設備市場成長



